

74310 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka/ ER

TENTTI .12.2004

- 1. Välitaytteen vaikutus liitoksen ominaisuuksiin? Perustele (5 p)**
- 2. CSP liittäminen (rakenne, edut ja vaikeudet). (5 p)**
- 3. MEMS –komponenttien liittäminen. (5 p)**
- 4. Lankaliitoksen luotettavuus.(5 p)**
- 5. Kerro lämpösykli-, lämpöshokki- ja 85/85-testeistä. Mikä on näiden testien käyttötarkoitus? (5 p)**